

T/SZBSIA 007-2022

ICS 31.070

团体标准

T/SZBSIA 007-2022

IC类半导体固晶机检测规范

Semiconductor die bonder test specification

2022-09-23发布

2022-9-24实施

深圳市宝安区半导体行业协会 发布

目录

前 言	1
1 范围	2
2 规范性引用文件	2
3 术语和定义	3
4 总则	3
4.1 检验分类	3
4.2 出厂检验	4
4.3 型式检验	4
5 一般要求	5
5.1 组成和分类	5
5.2 检查条件	6
5.3 检测工具	6
5.4 检测内容	6
6 检验方法及判定依据	6
6.1 检验准备	6
6.2 外观检验	6
6.3 加工及装配检验	7
6.4 整机性能检验	7
6.5 电气安全检验	12
附录A (资料性附录)	13
工能区防误入检测 (选配功能)	13
附录B (规范性附录)	14
定位精度检测	14
附录C (资料性附录)	15
噪声检测	15

前 言

本文件依据GB/T1.1-2020《标准化导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市宝安区半导体行业协会提出并归口。

本文件主要起草单位：深圳新益昌科技股份有限公司、深圳市宝安区半导体行业协会、深圳市洲明科技股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司、深圳雷曼光电科技股份有限公司、深圳市锐骏半导体股份有限公司、深圳市聚飞光电股份有限公司、深圳市秀武电子有限公司、深圳市信展通电子股份有限公司、深圳市宝安区集成电路产业技术创新联盟、深圳市时创意电子有限公司、深圳清华大学研究院、深圳市路远智能装备有限公司、深圳市振华兴科技有限公司、深圳市晶凯电子技术有限公司、深圳绘王趋势科技股份有限公司、深圳市三联盛科技股份有限公司。

本文件主要起草人：彭顺安、刘慧、于江情、郑文杰、曾晓明、王跃飞、余亮、黄泽军、孙平如、赵越、施锦源、马保峰、刘岩、敬刚、贾孝荣、廖怀宝、刘纪文、王周宏、张莹、朱文锋。

本标准是首次发布。